



PLOTECH

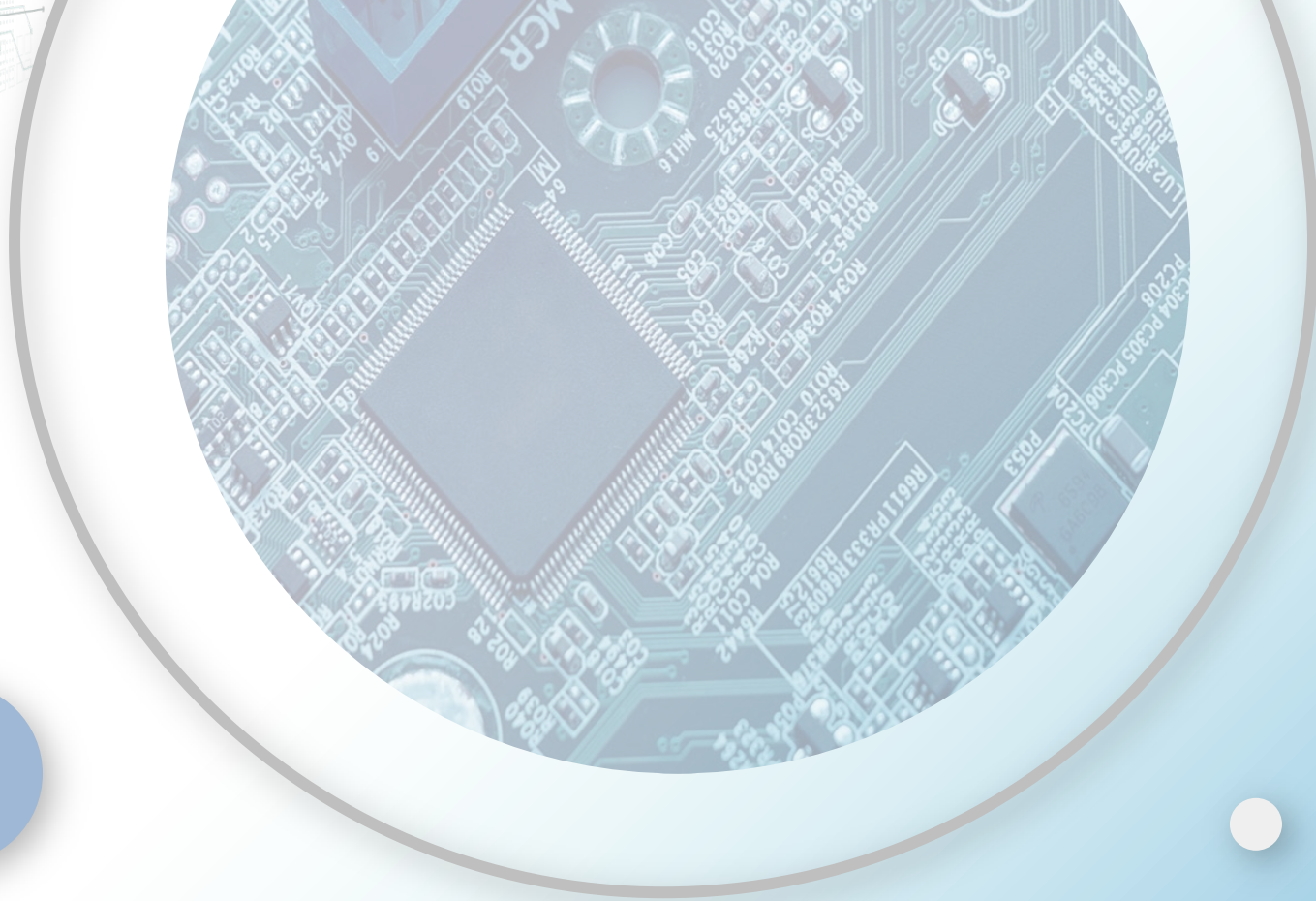
柏承科技股份有限公司

2021法人說明會

1 | 2021營運成果

近期重要事情摘要 | 2

CONTENTS 目錄

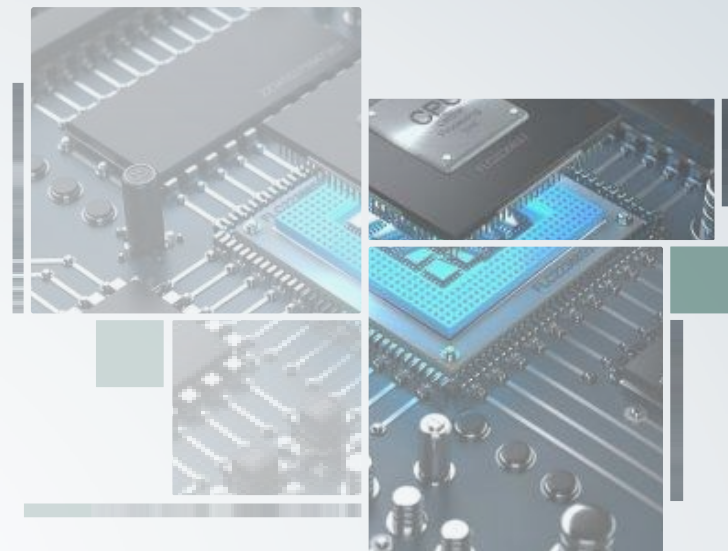


01

2021 第三季營運成果

01 綜合損益表

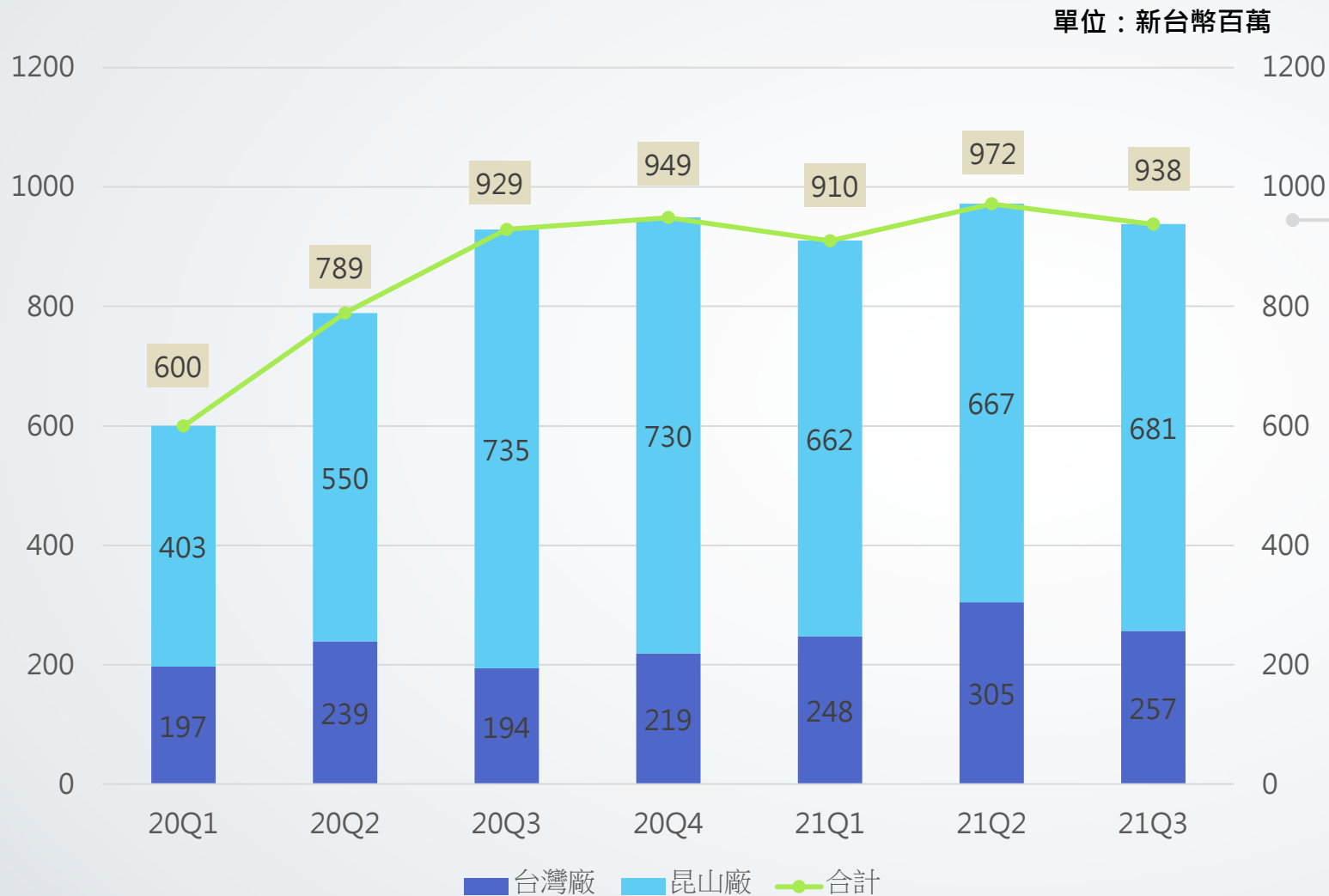
項目	1Q20	2Q20	3Q20	2020 Q1-Q3	1Q21	2Q21	3Q21	2021 Q1-Q3	QoQ	YoY
營業收入淨額	600	789	929	2,318	910	972	938	2,820	-3.50%	21.7%
營業毛利率%	13.5	19.8	22.5	19.2	22.3	21.9	21.6	22.0	-0.3ppts	2.8ppts
營業費用	68	80	86	234	102	99	104	305	5.1%	30.3%
營業淨利率%	2.2	9.5	13.2	9.1	11.2	11.7	10.6	11.2	-1.1ppts	2.1ppts
營業外收支	-10	4	30	24	4	14	11	29	-21.4%	20.8%
本期稅後淨利	2.6	55	120	177.6	86	86	86	258	0%	45.3%
純益率%	0.4	7.0	12.9	7.6	9.5	8.8	9.2	9.1	0.4ppts	1.5ppts
每股盈餘 (元)	0.02	0.42	0.93	1.37	0.62	0.63	0.63	1.88	0%	37.2%



單位：新台幣百萬

QoQ：Q3 vs Q2
YoY：(2021Q1~Q3) vs (2020Q1~Q3)

01 營收分析



2021年Q1-Q3昆山廠+臺灣廠
，營收比2020同期增幅21.7%



昆山廠

20年受疫情影響，2021年Q1-Q3比
2020同期上漲19.1%

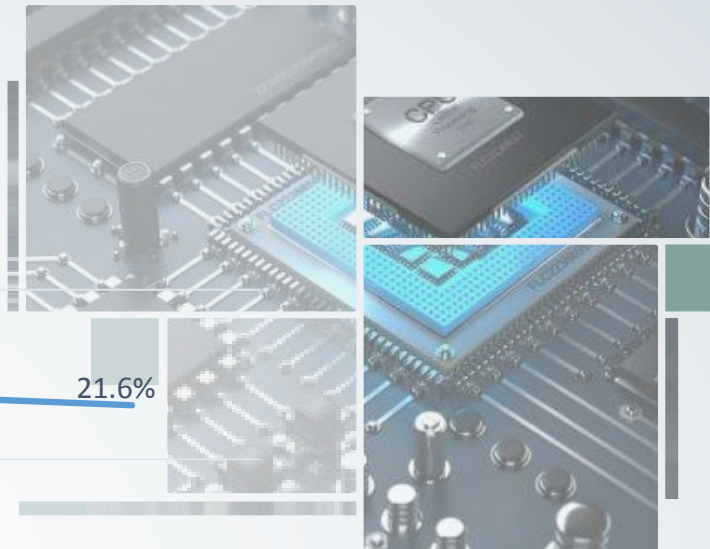
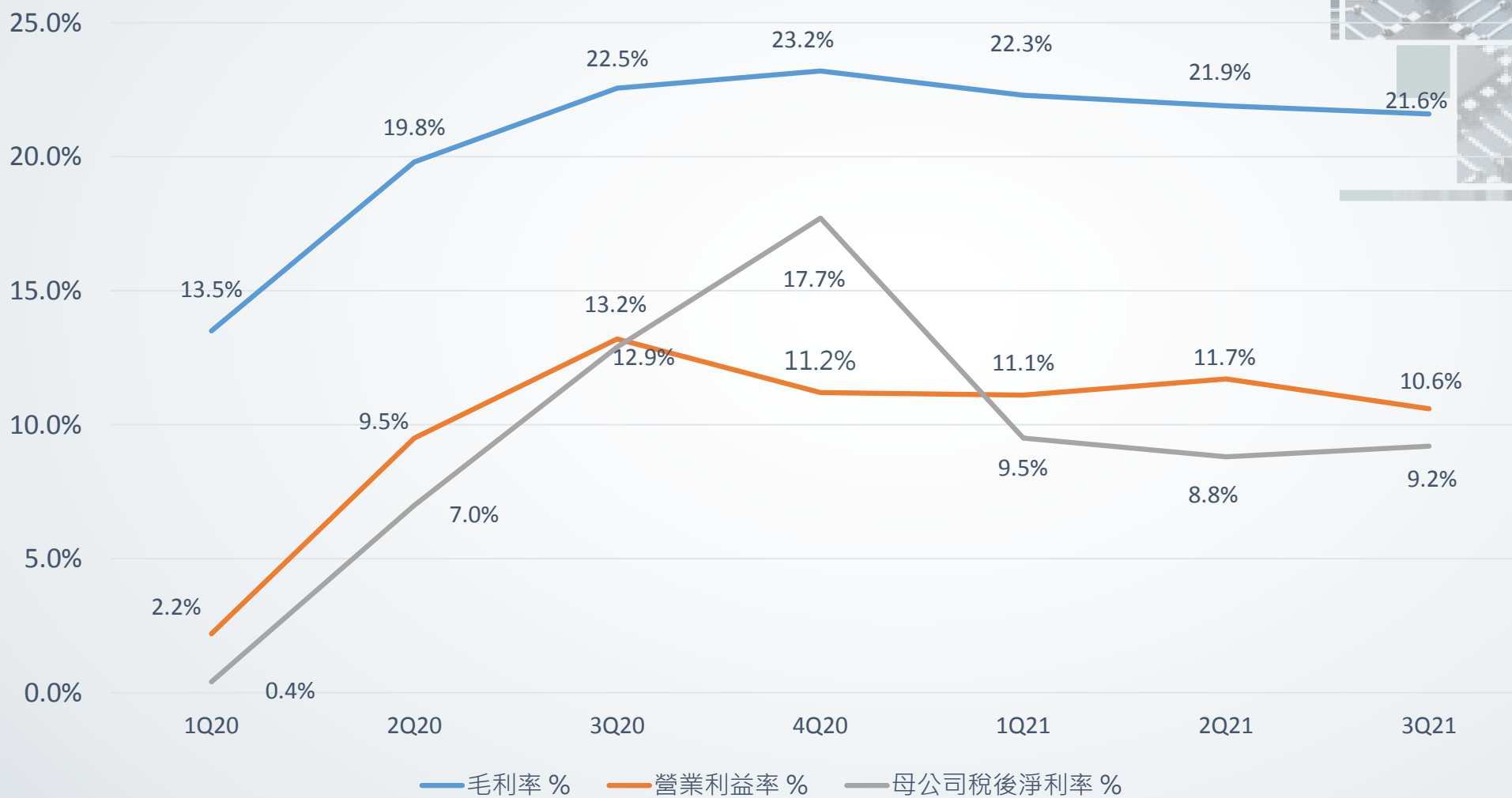


臺灣廠

2021Q1-Q3與2020年度同期營收相
比，上漲28.57%

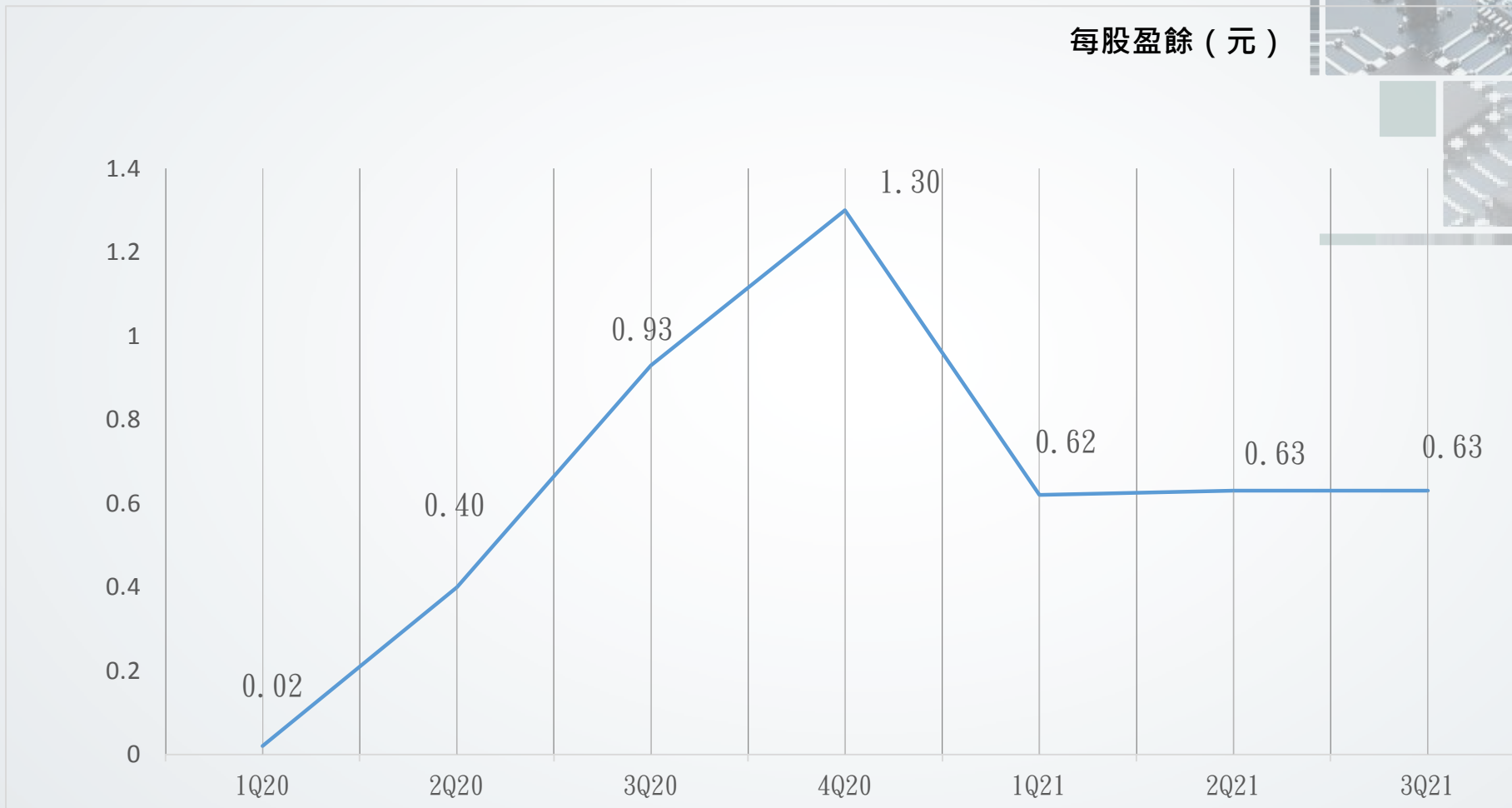
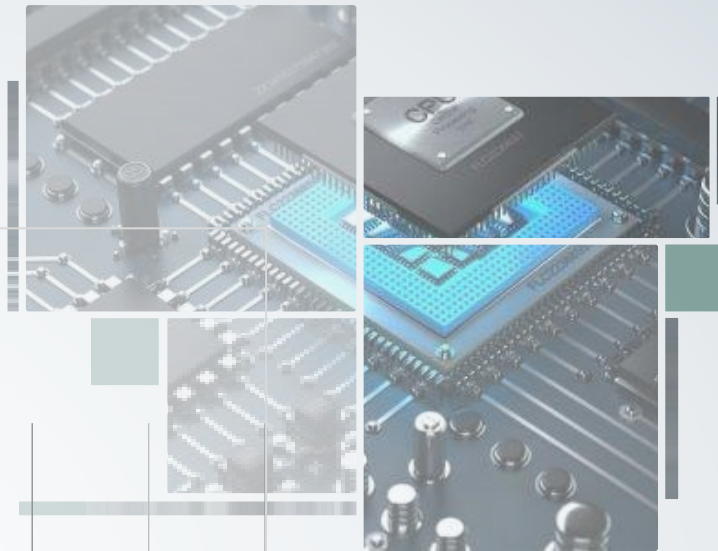
01

合併獲利指標



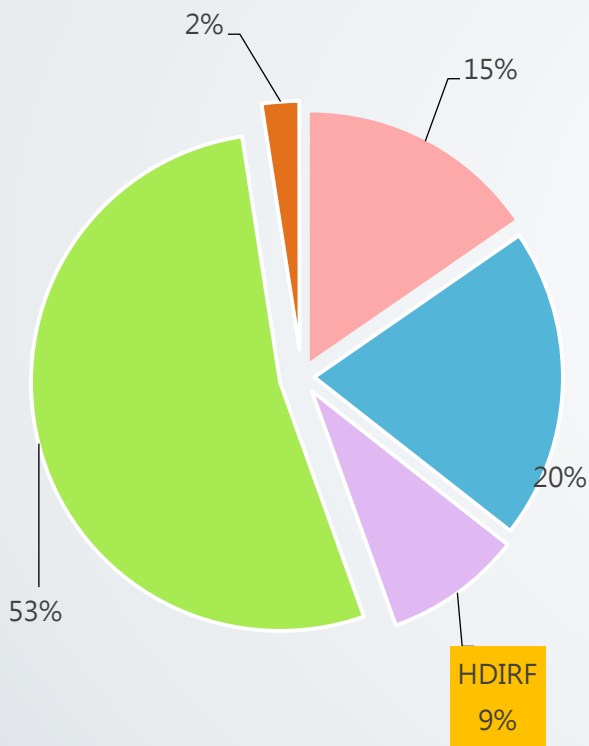
01

合併每股盈餘



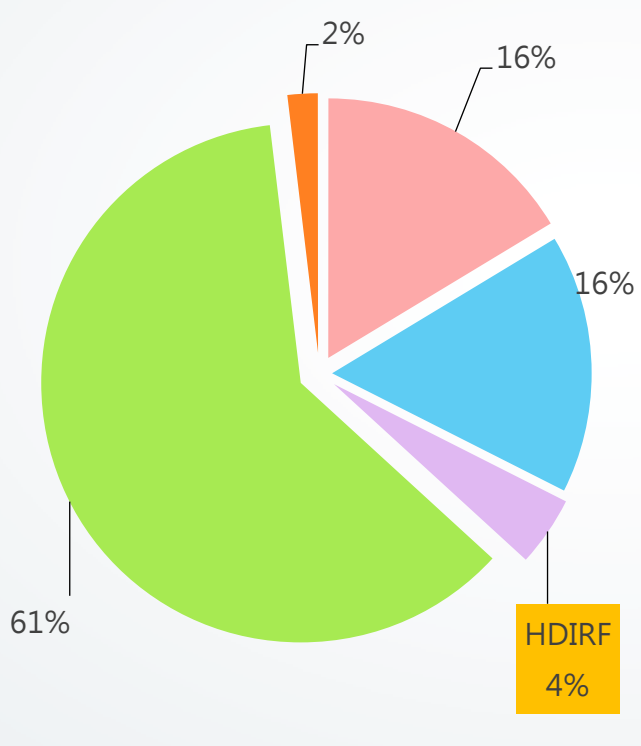
01 產品個別結構 - 昆山廠

2020全年製程別營收%



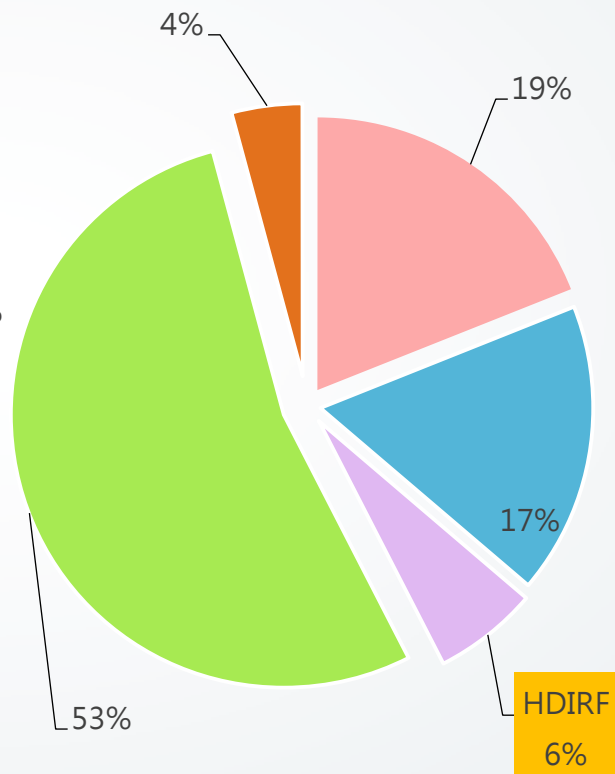
- 傳統板
- HDI一階
- HDIRF
- HDI二階
- HDIAnylayer

1Q21製程別營收%



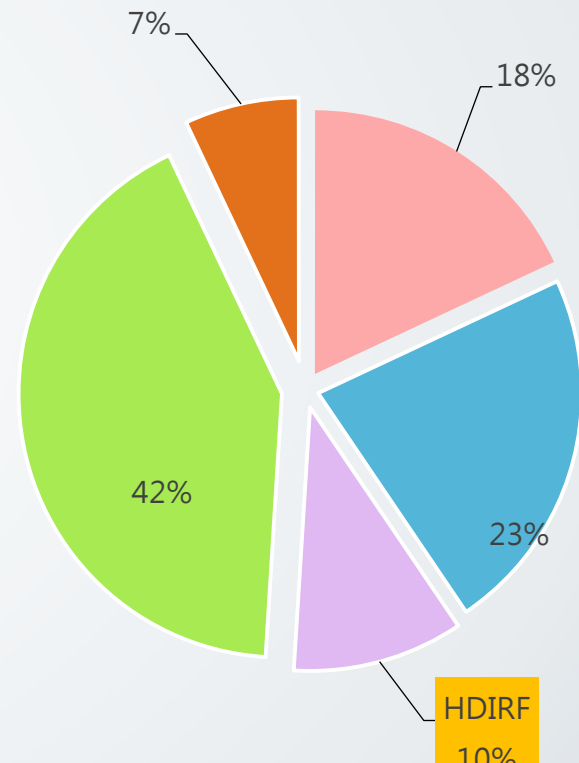
- 傳統板
- HDI一階
- HDIRF
- HDI二階
- HDIAnylayer

2Q21製程別營收%



- 傳統板
- HDI一階
- HDIRF
- HDI二階
- HDIAnylayer

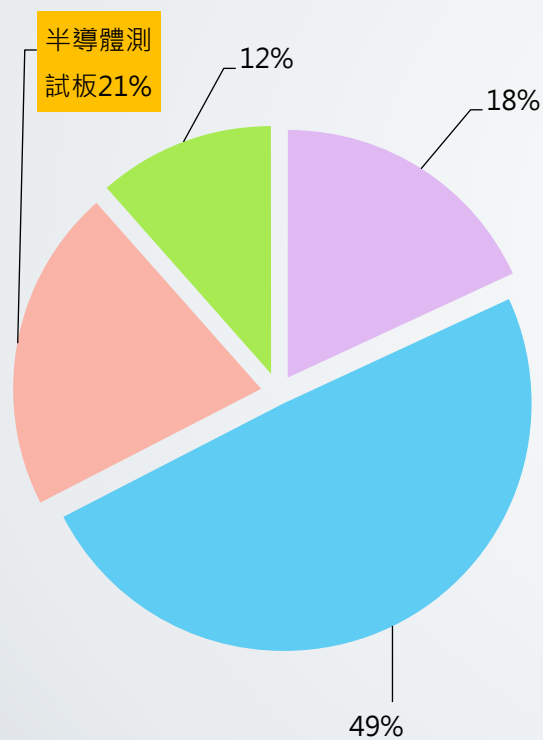
3Q21製程別營收%



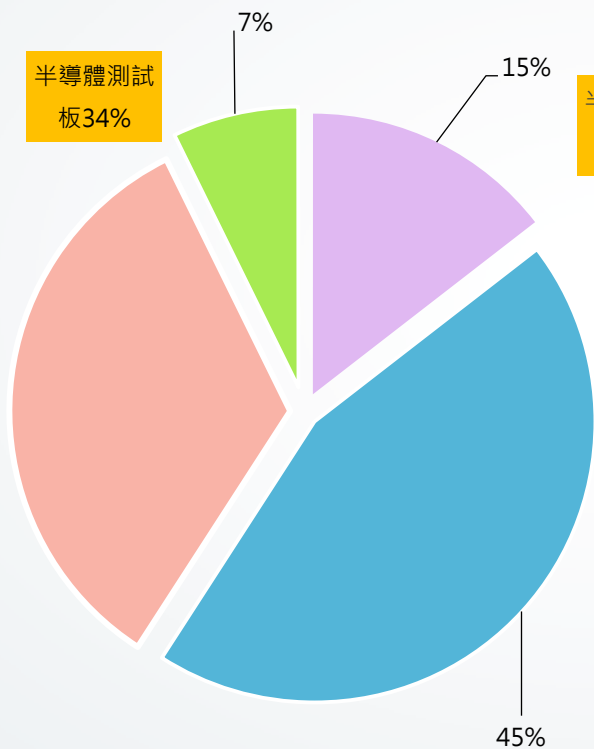
- 傳統板
- HDI一階
- HDIRF
- HDI二階
- HDIAnylayer

01 產品個別結構 - 臺灣廠

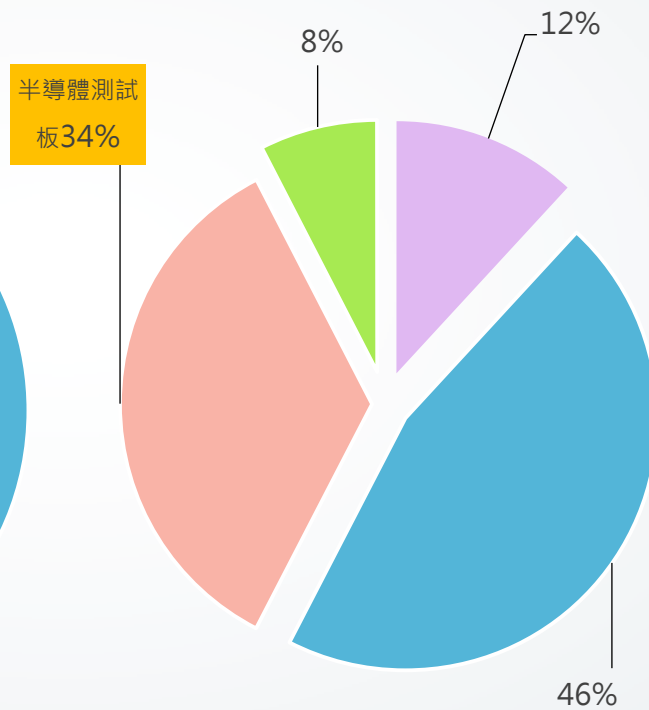
2020全年製程別營收%



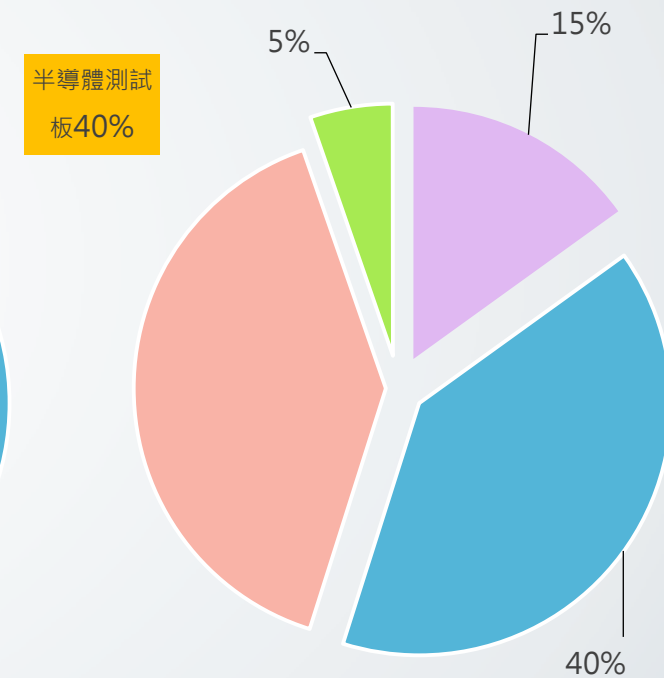
1Q21製程別營收%



2Q21製程別營收%



3Q21製程別營收%

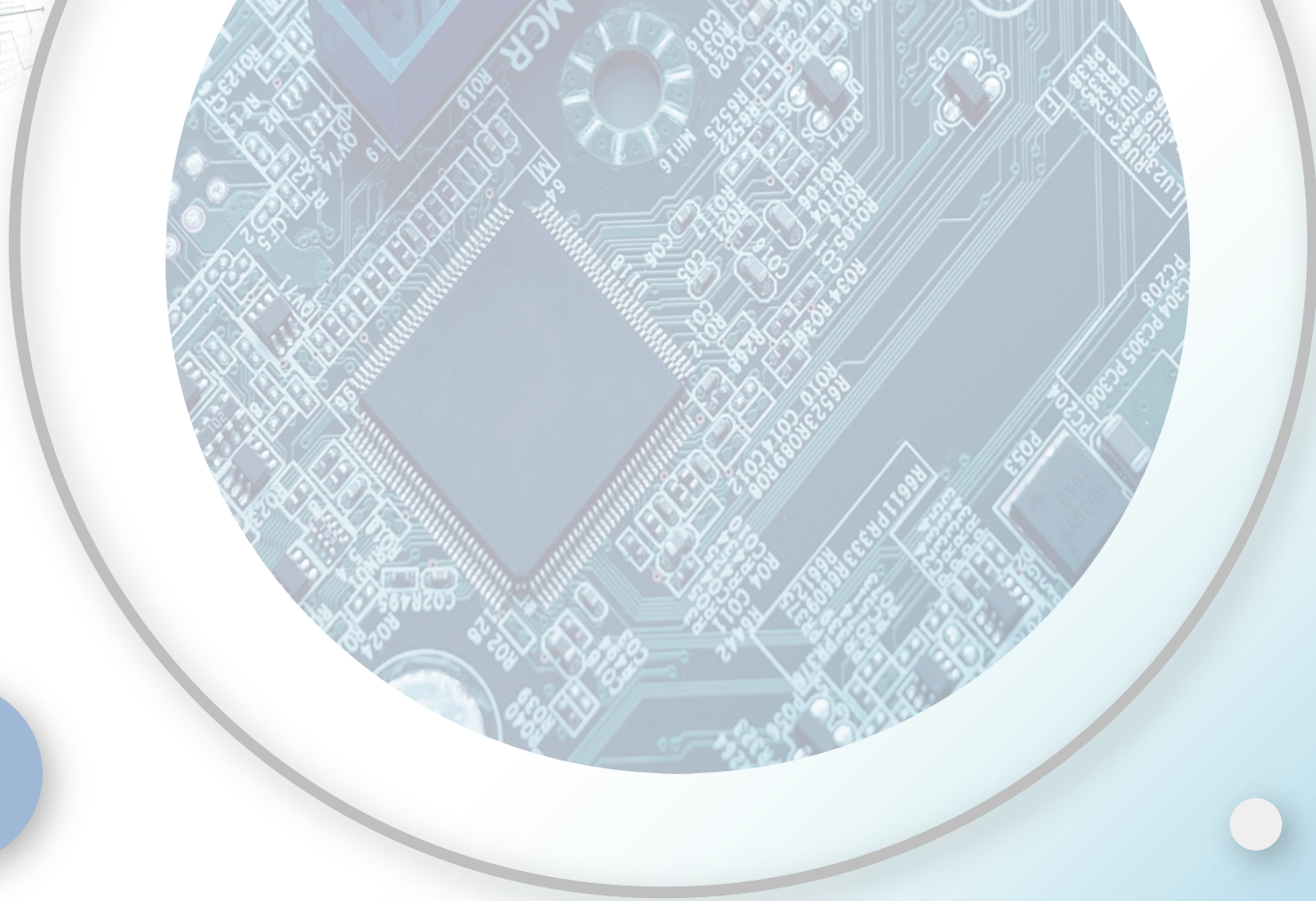


樣品 量產 半導體測試板 商品

樣品 量產 半導體測試板 商品

樣品 量產 半導體測試板 商品

樣品 量產 半導體測試板 商品



02

近期重要事情摘要

02

市場開發

HDI 軟硬結合板 ：智能耳機、智能手錶等

產品運用：HDIRF-藍牙耳機
目前進度：樣品已經送樣承認

HDI 高階電路板 ：智能消費性電子產品

產品運用：HDI-電話手錶、小米筆記本
目前進度：Audit完成



HDI 高階電路板： 5G 產品(通訊模組、IOT)

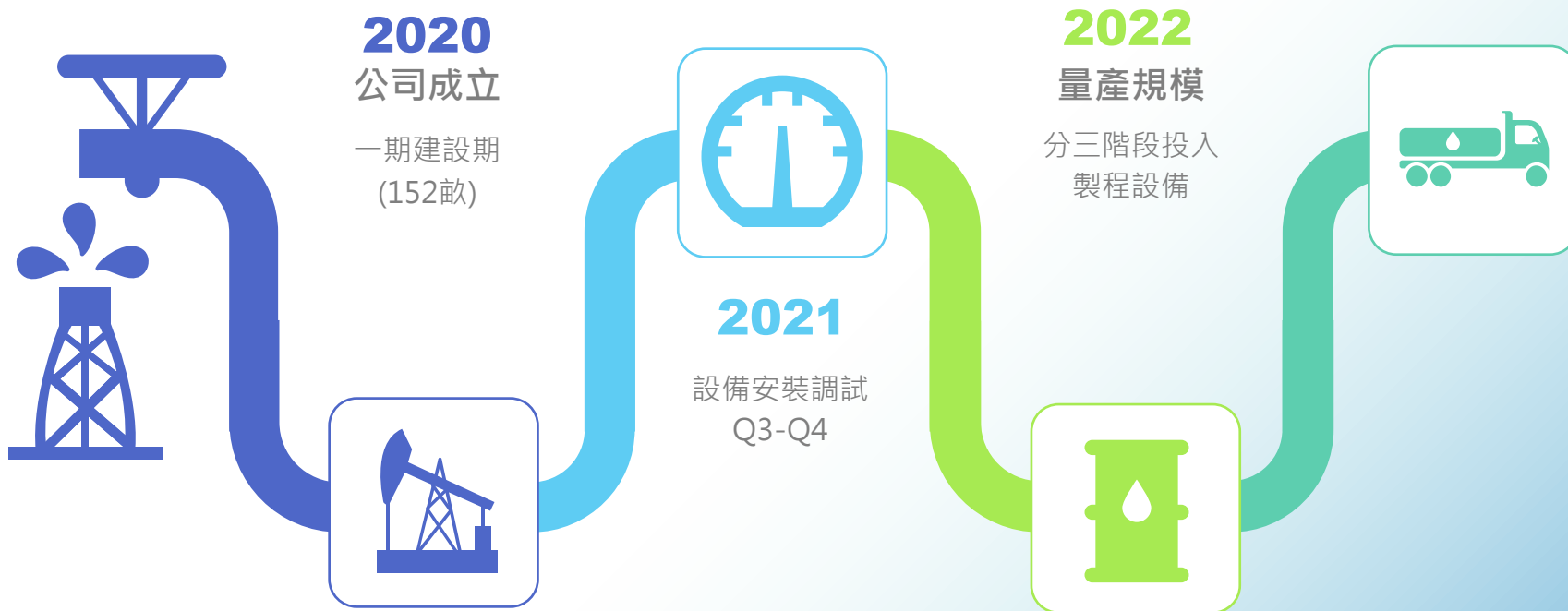
產品運用：高階HDI-5G模組
目前進度：樣品認證通過

HDI 高階電路板-LED

產品運用：LED
目前進度：樣品階段

02

南通柏承投產時間



Q & A